

## TIA211G

## 放熱シリコンポッティング材

LI-81-21171 Issued July, '21  
Silicones & Specialties,  
Electronics Business Technology, TIM  
Momentive Performance Materials Japan LLC

TIA211G は、電気電子部品の放熱、絶縁封止を目的とした 2 成分付加型の液状シリコンゴムです。(A)成分と(B)成分を 1:1 の割合で混合し、室温あるいは加熱することにより、柔らかいゴム・ゲル状に硬化します。硬化後は、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れ、広い温度範囲で安定した放熱性と電気絶縁性を示します。

**特長**

- ◆ 熱伝導率が高く、放熱用に適しています。
- ◆ 混合比が 1:1 (重量比)の使いやすい 2 成分形です。
- ◆ 低粘度で作業性に優れ、ポッティング用途に好適です。
- ◆ 50℃以上の加熱により、短時間で硬化します。
- ◆ 硬化後は柔らかいゴム・ゲル状ですので、各種ストレスから部品を保護します。
- ◆ 耐熱性、耐寒性に優れ、硬化後は -40~+150℃の広い温度範囲で使用できます。

**一般特性**

| 硬化前 (23℃)                                       | TIA211G(A) | TIA211G(B) |
|---|------------|------------|
| 外 観   | 灰色流動性      | 灰白色流動性     |
| 粘 度 Pa·s  | 8          | 6          |
| 混合比 (重量部)                                       | 1:1        |            |
| 混合直後粘度 Pa·s                                     | 7          |            |
| 作業可能時間 h  | 0.5        |            |
| 硬化条件 (加熱時) °C/h                                 | 70 / 0.5   |            |
| 硬化条件 (常温時) h                                    | 8          |            |
| 硬化後 (硬化条件: 70℃, 0.5h)                           |            |            |
| 外 観   | 灰色ゴム状      |            |
| 熱伝導率 <sup>1</sup> W/m·K                         | 1.1        |            |
| 密 度 g/cm <sup>3</sup>                           | 2.07       |            |
| 硬さ (タイプE)                                       | 40         |            |
| 低分子シロキサン (D <sub>3</sub> -D <sub>10</sub> ) ppm | 200        |            |

1) 熱線法による

記載のデータは、弊社の試験方法による実測値・特性例であり、規格値ではありません。ご使用に際しては、貴社使用条件に適合するか必ずご確認願います。なお、本品の用途に関して、いかなる特許にも抵触しないことを保証するものではありません。

**取扱い上の注意および保管について**

- (1) 被着体の表面に油脂などが付着していると硬化が不十分となりますので、溶剤などで脱脂し乾燥してください。
- (2) アミン、スズ、イオウなどを含むものと接触すると、硬化しないことがありますのでご注意ください。
- (3) 保存中に充填剤が沈降することがありますので、均一に混合してから使用してください。
- (4) 取扱い時には、保護眼鏡および必要に応じて、保護手袋を着用してください。
- (5) 局所排気装置を運転し、換気をよくして作業してください。
- (6) 直射日光を避け、湿気の少ない冷暗所に保管してください。

**消防法**

非危険物。指定可燃物可燃性液体類に該当。